

산 에칭 및 세척 공정용 Ptfе 실리콘 웨이퍼 홀더 2 4 6 8인치 맞춤형 고온 내성

품목 번호: PL-CP158



소개

극한의 산 에칭 및 세척 공정을 위해 설계된 고순도 PTFE 실리콘 웨이퍼 홀더입니다. 2~8인치 웨이퍼에 최적화된 이 견고한 맞춤형 캐리어는 B2B 조달을 위한 가장 까다로운 반도체 제조 환경에서 오염 없는 취급과 열 안정성을 보장합니다.

자세히 알아보기

응용 분야	설명	주요 이점
반도체 에칭	유전체 층을 제거하기 위해 농축 HF 또는 BOE(버퍼 산화물 에치) 용액에서 웨이퍼 핸들링.	공격적인 산에 대한 탁월한 내성은 장기적인 캐리어 내구성을 보장합니다.
RCA 세척 공정	유기 및 금속 오염 물질을 제거하기 위해 고온에서 SC-1 및 SC-2 용액 사용.	높은 열 안정성은 고온 산화 욕조 중 변형을 방지합니다.
광전지 셀 생산	고효율 태양 전지 제조 중 실리콘 웨이퍼의 텍스처링 및 세척.	견고한 설계는 일관된 신뢰성으로 대량 산업 처리량을 처리합니다.
MEMS 제조	복잡한 딥 반응 이온 에칭 및 습식 방출 공정 중 기관의 안전한 고정.	정밀하게 가공된 슬롯은 섬세한 미세 기계 구조를 접촉 손상으로부터 보호합니다.
피라냐 에칭 클리닝	과산화수소와 황산의 혼합물에서 웨이퍼를 처리하여 중유기물을 스트리핑합니다.	재료는 강한 산화 공격에 면역되어 장비 성능 저하를 방지합니다.
나노 기술 연구	실험적인 화학 기상 증착 또는 액상 처리에서 맞춤형 기관의 특수 핸들링.	완전한 맞춤화를 통해 비표준 웨이퍼 크기와 고유한 형상 지원이 가능합니다.
광전자 조립	에피 성장 또는 박막 증착 전 사파이어 또는 GaAs 웨이퍼 세척.	PTFE 재료의 순도는 광학 장치에서 미량 금속 간섭의 위험을 제거합니다.

사양 카테고리	PL-CP158에 대한 매개변수 세부 정보	가용성/옵션
모델 시리즈	PL-CP158 실리콘 웨이퍼 캐리어	표준 및 맞춤형 디자인
주요 재료	고순도 PTFE(폴리테트라플루오로에틸렌)	요청 시 PFA 옵션 사용 가능
호환 가능한 웨이퍼 크기	2인치, 4인치, 6인치, 8인치	모든 직경으로 완벽하게 맞춤 설정 가능
슬롯 구성	용량 및 피치는 프로젝트별로 정의됨	사용자 사양에 따라 맞춤 설정
온도 범위	극저온에서 260°C까지 작동	공정별 맞춤 설정
내화학성	산, 염기 및 용매의 전체 범위	보편적인 화학적 호환성
제조 방법	5축 CNC 정밀 가공	맞춤형 형상 사용 가능
배수 기능	맞춤형 하단/측면 배수 포트	특정 목적 용량에 최적화됨
핸들 디자인	분리형 또는 통합형 수동/로봇 핸들	도구 호환성을 위해 맞춤 설정
순도 등급	미량 분석 및 반도체 등급	인증된 고순도 재료